

证券代码：301041

证券简称：金百泽

公告编号：2023-045

## 深圳市金百泽电子科技股份有限公司

### 关于参加知识产权资产证券化项目及融资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》，同意参加知识产权资产证券化项目，将公司及子公司名下有权处分的四项专利权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司（以下简称“高新投小额贷款”），向高新投小额贷款申请最高额度不超过人民币 4,000 万元、期限为一年期的综合授信；并委托深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投担保”）为公司上述授信提供连带责任保证担保。现将有关事项公告如下：

#### 一、融资概述

本次申请的综合授信将用于公司补充流动资金，以上贷款额度方案最终以实际审批结果为准，具体融资金额将根据公司运营资金的实际需求来确定，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次融资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次申请综合授信额度事项不构成关联交易。

#### 二、交易对手方介绍

##### 1、贷款方

贷款方名称：深圳市高新投小额贷款有限公司

统一社会信用代码：914403003060169615

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：119,000 万元人民币

法定代表人：曾瑋

成立日期：2014年5月13日

经营期限：2014年5月13日至2034年5月13日

住所：深圳市罗湖区东门街道深南东路2028号罗湖商务中心35楼10-25单元

经营范围：许可经营项目是：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	100%
合计		100%

关联关系或其他利益说明：高新投小额贷款及其股东、董监高与公司及其控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，亦不是失信被执行人。

## 2、担保方

担保方名称：深圳市高新投融资担保有限公司

统一社会信用代码：91440300571956268F

企业类型：有限责任公司

注册资本：700,000万元人民币

法定代表人：樊庆峰

成立日期：2011年4月1日

经营期限：2011年4月1日至2031年4月1日

住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

经营范围：一般经营项目是：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

股权结构：

序号	股东名称	持股比例
1	深圳市高新投集团有限公司	46.34%
2	深圳市罗湖投资控股有限公司	27.07%
3	深圳市投资控股有限公司	26.60%
合计		100%

注：上表合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。

关联关系或其他利益说明：高新投担保及其股东、董监高与公司及公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排，未以直接或间接形式持有公司股份，亦不是失信被执行人。

### 三、业务基本情况

1、债权人：深圳市高新投小额贷款有限公司

2、债务人：深圳市金百泽电子科技股份有限公司

3、授信额度：不超过 4,000 万元人民币

4、授信额度有效期限：自授信额度合同生效之日起一年，贷款期间以实际签署的借款合同约定的日期为准；

5、质押担保措施：

(1) 以公司及子公司名下有权处分的 4 项发明专利作为质押担保，4 项专利具体情况如下：

序号	专利名称	专利号
1	一种改善铝基混压结构层压板翘的控制方法及 PCB 板	ZL202110654386.8
2	一种 PCB 阻胶结构及其精确阻胶控制方法	ZL202211660170.3
3	一种具有高散热性结构的 PCB 板及其加工方法	ZL202210232256.X
4	一种刚挠结合印制板生产方法	ZL200910192873.6

(2) 高新投担保为上述贷款向高新投小额贷款提供连带责任保证担保。

具体贷款条款及担保措施，以各方最终签署的各项合同为准。公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关综合授信及质押手续，并代表公司签署办理综合授信及质押手续所需合同、协议及其他法律文

件。

#### **四、对公司的影响**

本次参加的知识产权资产证券化项目及融资业务，有利于降低融资成本，拓宽融资渠道，符合公司的未来发展规划和经营管理需要，不会对公司正常经营与业务发展造成不良影响，不会损害公司股东及中小股东的利益。

#### **五、履行的审议程序和相关意见**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》。经审议，董事会认为：本次知识产权资产证券化项目及融资业务，有利于降低融资成本，拓宽融资渠道，符合公司未来发展规划和经营管理需要，董事会同意公司本次参加知识产权资产证券化项目及融资的事项，同意公司在额度范围内授权公司管理层根据公司实际用款需求办理有关综合授信及质押手续，并代表公司签署办理综合授信及质押手续所需合同、协议及其他法律文件。

##### **（二）监事会意见**

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司参加知识产权资产证券化项目及融资的议案》。经审核，监事会认为本次知识产权资产证券化项目及融资业务，有利于降低融资成本，拓宽融资渠道，符合公司整体发展需要和深圳证券交易所等有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司参加知识产权资产证券化项目及融资的事项。

##### **（三）独立董事发表的独立意见**

独立董事认为：公司本次拟将公司及子公司名下有权处分的四项专利权质押给深圳市高新投小额贷款有限公司，向其申请最高额度不超过人民币 4,000 万元、期限为一年期的综合授信，并委托深圳市高新投融资担保有限公司提供担保，有助于公司降低融资成本，拓宽融资渠道，符合公司发展需要。本次交易符合法律、法规及公司章程的有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司本次参加知识产权资产证券化项目及融资事项。

## 六、备查文件

- （一）第五届董事会第七次会议决议；
- （二）第五届监事会第七次会议决议；
- （三）独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会

2023年10月27日